

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

股票名称：拓荆科技

股票代码：688072

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流、网络会议等形式）
参与单位名称	汇添富基金、南方基金、国盛证券、国新投资、华西证券、国联安基金、国泰基金、太平基金、汇丰晋信基金、西部利得基金、长信基金、财通资管、中金资管、中银资管、睿远基金、中海基金、恒越基金、长安基金、金鹰基金、富安达基金、富国基金、东方红资管、东吴基金、华创证券、华泰证券、方正证券、泰康资产、鹏华基金、西部证券、中泰证券、太平养老保险、国泰君安证券、中邮证券、中信证券、工银瑞信基金、华福证券、申万菱信基金
时间	2024年6月13日至2024年7月4日
地点	沈阳、网络会议
公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：赵曦 公司证券事务代表：刘锡婷
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节主要内容： 1. 公司预计2024年上半年新签订单如何？预计全年新签订单的趋势情况？

答：公司预计 2024 年上半年新签订单情况良好。随着公司设备产品覆盖度的持续提升，市场应用规模不断扩大，且公司持续保持高强度的研发投入，迭代升级各产品系列，满足客户在技术节点更新迭代过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。公司在 2024 年上半年持续获得下游客户的新签订单，包括新型工艺机台的复购订单，目前公司在手订单充足，且保持增长态势。基于公司产品在客户端的验证和应用表现，以及下游客户的需求情况，公司对 2024 年全年新签订单的趋势保持乐观的态度。

2. 公司预计 2024 年第二季度和全年的营业收入情况如何？

答：公司目前在手订单饱满，为公司 2024 年营业收入提供支撑，预计 2024 年第二季度和全年的营业收入将继续保持增长态势，具体请关注公司后续披露的相关信息。

3. 公司产品的竞争优势主要体现在哪里？目前在客户端覆盖情况和应用情况如何？

答：公司自成立开始就一直聚焦在高端半导体专用设备领域，并专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化。公司经过多年的自主创新和经验积累，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并推出了 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 等薄膜设备产品和混合键合设备。公司薄膜设备产品均已在集成电路领域实现规模

量产，截至 2023 年末，累计出货超过 1500 个反应腔，在客户端产线生产产品的累计流片量已突破 1.56 亿片。公司薄膜设备产品可以支撑逻辑芯片、存储芯片中所需的全部介质薄膜材料和约 100 多种工艺应用，覆盖面广且在客户端产线生产运行稳定性表现优异，平均机台稳定运行时间 (Uptime) 超过 90%，达到国际同类设备先进水平。

公司持续紧跟客户需求，在现有量产产品的基础上，不断进行产品的迭代创新和工艺拓展，以满足客户在技术节点更新迭代的过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。公司具有丰富的技术储备和专业的研发团队，针对客户提出的特定工艺材料、特定制造工序薄膜性能的快速响应能力可以及时满足客户产线的客制化设备需求，这对下游晶圆制造厂能够快速扩充产能极其重要，由此建立和巩固与客户稳定的合作关系。

4. 公司混合键合设备进展情况如何？

答：2023 年，公司晶圆对晶圆键合设备和芯片对晶圆混合键合前表面预处理设备均顺利通过客户端验证，实现了产业化应用，且均为国产首台，性能表现优异。目前公司在持续推进现有两款产品的客户拓展，并进一步探索在存储芯片、图像传感器、先进封装等更多领域的应用。

5. 公司的薄膜设备产品与海外厂商是否还有差距？

答：目前公司成熟产品的核心技术及关键性能指标均已达到国际同类设备先进水平，并在客户端广泛应用。公司近几年陆续推出先进产品到客户端验证，目前处于逐步放量阶段。此外，公司作为本土供应商，可以为客户提供定制化产品，满足客户差异化需求，并提供及时、快速的售后服务。

6. 公司当前薄膜设备市场占有率大概有多少？未来预计达到多少？

答：根据 SEMI 统计，2023 年全球半导体设备的销售额达 1,063 亿美元。2023 年晶圆制造设备销售额约占总体半导体设备销售额的 90%，达到约 960 亿美元。薄膜沉积设备市场规模约占晶圆制造设备市场的 22%，由此推算，2023 年全球薄膜沉积设备市场规模约为 211 亿美元。结合中国大陆半导体制造设备销售额占全球半导体制造设备的销售额约为 29% 的比例推测算，2023 年中国大陆薄膜沉积设备市场规模约为 61 亿美元。在薄膜沉积设备中，PECVD 是薄膜设备中占比约为 33%，ALD 设备占比约为 11%，SACVD 和 HDPCVD 占比约为 6%。因此，公司产品所覆盖的中国大陆市场规模约为 30.5 亿美元（约为 221 亿人民币），公司 2023 年实现营业收入 27.05 亿人民币，由此计算，公司产品在中国大陆的市场占有率约为 12.23%。目前公司产品在中国大陆的市场占有率仍较低，未来仍有较大的发展空间。

7. 公司是否有其他领域或其他新产品的布局？

答：公司主要聚焦在高端半导体设备领域，目前主要围绕化学气相薄膜沉积技术领域及混合键合技术领域拓展新技术和新产品，并持续进行产品迭代创新，扩大覆盖面和应用规模，力争通过专精深的专业技术在上述领域实现快速发展，保持细分领域的领先地位，目前暂无计划拓展其他领域。